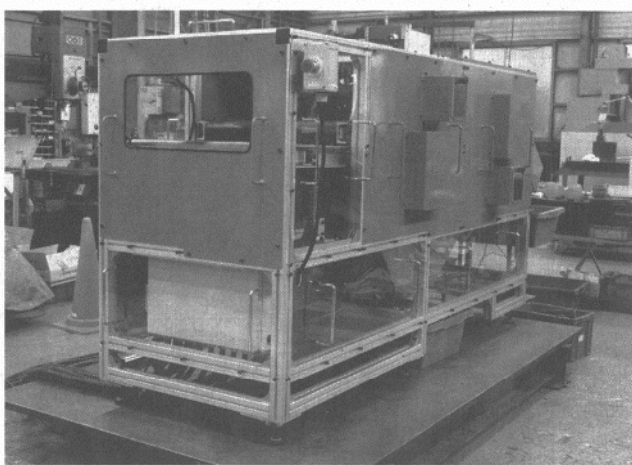


基板両面から部品剥離

エムダイヤ、新装置投入

【富山】エムダイヤ(富山県滑川市、森弘吉社長、076・476・0062)は、使用済み電子基板から実装部品(チップ)を剥ぎ取る基板剥離機「エココレクター」の新型を3月に発売する。従来機は基板の片面だけからチップを剥離していたが、新型は両面処理が可能。チップ抽出の省人化と効率化ができる。チップから金を中心とした貴金属やレアメタル(希少金属)などを得る「都市鉱山」の事業に取り組みりサイクル企業や精錬企業に売り込む。価格は3500万円程度の見込み。年間5~10台の販売を目指す。



開発中のエココレクター

剥離に用いる工程を二つ設け、剥離時は独自の技術を駆使し、両面処理を実現した。関連する3件の技術について特許を出願済み。従来は対応する基板の大きさが縦横300ミリ以上だったが、新型は縦横120ミリ以上からになる。従来はデスクトップパソコンや大型テレビなどの基板が主だった対象が、ノートパソコンやタブレットといったより小さな機器の基板に広がる。

IoT(モノのインターネット)で稼働率や機械の状況をリモート診断する機能や、遠隔で緊急停止する機能を搭載し、生産性や保守性が向上する。使用済み電子基板のチップは「都市鉱山」として注目され、それから有価金属を取り出しやすくするエココレクターは需要の伸びが期待される。電子基板はチップの実装密度向上に伴い小型化と両面化が進んでいることから、小型基板のチップ剥離を両面処理できる新型の投入で、需要取り込みを図る。新型は3月17日に東京・有明の東京ビッグサイトで開幕する「2021N EW環境展・地球温暖化防止展」に出展する。